



2017/08/31

免責聲明

- 本次法說會所提供之簡報內容可能包括對於未來狀況之預測及評估關於未來狀況之陳述乃基於公司目前可得資料所做的預測，涉及風險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形本公司並不保證簡報內容之正確性，亦不負有更新或修正簡報內容之責任。
- 簡報內容非經由本公司書面許可，任何第三者不得任意取用或複製。

議程

- 市場及營運重要訊息
- 2017年上半年營運成果
- 問與答



市場及營運重要訊息

市場訊息

- ◆ 2017/3/30，IC Insights上修2017年全球半導體市場年成長率為11%，大幅高於原預估的5%，但若扣除DRAM及NAND Flash等記憶體市場的強勁成長，2017年半導體市場年成長率將只剩下4%。
- ◆ 2017/4/18，台積電在記憶體市場強勁帶動下，預估2017年半導體產值成長7%，高於原預估的4%，但受供應鏈庫存調整影響，今年晶圓代工產值將僅成長5%，低於原預期的7%。
- ◆ 隨著下半年多款智慧型手機即將問市，預期智慧型手機市場將持續成長。

營運訊息

- ◆ 本公司2017年第2季營業收入NT\$1,869佰萬元，較第1季營業收入NT\$1,801佰萬元增加3.8%；2017年第2季歸屬於母公司淨利NT\$252佰萬元，較第1季歸屬於母公司淨利NT\$227佰萬元增加11%。
- ◆ 本公司2017年上半年營業收入NT\$3,670佰萬元，較2016年同期營業收入NT\$2,723佰萬元增加34.8%；2017年上半年歸屬於母公司淨利NT\$479佰萬元，較2016年同期歸屬於母公司淨利NT\$332佰萬元增加44.3%。
- ◆ 本公司2017年上半年每股盈餘NT\$1.03元，2016年同期每股盈餘NT\$0.71元。

業務進展

- ◆ 持續與美國及歐洲主要IDM領導廠商深化合作，耕耘「微控制器(MCU)」產品領域，尤其在汽車電子領域業務顯著成長。
- ◆ 整合在「微控制器(MCU)」、「射頻(RF)」、「資安」等相關領域的測試技術、解決方案及測試環境的開發進展，對準半導體應用的主要創新發展方向，以躋身物聯網相關應用領域重要供應商為目標邁進。
- ◆ 日本市場業務持續開展，與日本知名IDM公司合作，於消費性及汽車電子產品等領域，已進入量產階段。

業務進展

- ◆ 持續擴展晶圓級封裝(WLCSP)一元化測試服務業務，以因應未來業務成長需求。
- ◆ 成功建立氮化鎵製程的晶圓測試生產線，持續推動測試技術及工程開發，並成功開發新客戶。
- ◆ 持續拓展印刷電子標誌服務，該技術使用於無線射頻(RFID)和短距無線通訊(NFC)產品。

策略性投資進展

- ◆ 水平式擴張-增加無線射頻測試(Wireless/RF Test)服務領域：
於106/8/30完成無線射頻測試大廠全智科技(Giga Solution Tech)以現金為對價之100%股份轉換案，將加速營運綜效，提供客戶更完整的測試服務藍圖，可望成為物聯網供應鏈的重要廠商。
- ◆ 垂直式擴張-加深在供應鏈上的服務縱深：
在105/8/10投資瑞峰半導體(Raytek Semiconductor)32%股權後，瑞峰半導體已建立重佈局繞線(RDL)與凸塊(Bumping)的基礎產能，通過客戶驗證並已完成多項元件設計定案(Tape-out)，整合本公司WLCSP後段服務產能，可望為客戶提供高端WLCSP一元化測試服務。

大陸地區投資進展

- ◆ 為延伸台灣半導體供應鏈的領導地位，深化與國際級半導體廠商合作擴展全球市場，本公司已於105/11/30取得經濟部投審會核准大陸地區投資計劃，投資金額為US\$45M。
- ◆ 已於106/1/5於中國江蘇省南京市，成立了100%持股的測試廠-欣銓(南京)集成電路有限公司，廠房與台積電南京廠鄰近；本項投資執行進度並已於106/8/4向經濟部投審會完成申報。
- ◆ 欣銓(南京)集成電路有限公司已於106/4/21開工動土，並於106/8/21完成上樑典禮，各項建廠進度均依計劃執行中。

全球客戶的肯定

■ 美國重量級半導體IDM與知名IC設計公司的肯定

- ◆ 103年4月榮獲美國國際重量級IDM客戶頒發102年度Supplier Excellence Award，本次獲獎係自93年以來第三次獲得該獎項，該公司係欣銓科技的長期合作夥伴。
- ◆ 103年4月榮獲美國重量級客戶頒發卓越供應商獎，對進一步深化車用電子市場領域，有重要意義及鼓舞。
- ◆ 104年6月榮獲美國重量級半導體IDM大廠頒發「2015年度鑽石供應商獎」。
- ◆ 104年11月榮獲某美商快閃記憶體公司頒發2014年度Best in Class Supplier Award，本次獲獎係自97年以來第三次獲得該獎項。
- ◆ 106年4月榮獲美國國際重量級IDM客戶頒發105年度Supplier Excellence Award，本次獲獎係自93年以來第四次獲得該獎項，該公司係欣銓科技的長期合作夥伴。

全球客戶的肯定

■ 歐洲重量級半導體IDM的肯定

- ◆ 103年10月榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠，頒發「2014年度感謝獎」。
- ◆ 104年3月榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠頒發「2014年度卓越服務與傑出支援獎」。
- ◆ 104年9月榮獲歐洲重量級IDM半導體大廠頒發「2015年度感謝獎」，表揚欣銓傑出的績效及優異的量產支援。
- ◆ 104年10月榮獲歐洲重量級IDM半導體大廠於全球供應商日，頒發矽晶圓廠類別之「2015年度傑出供應商獎」，此次獲獎係繼「2014年度感謝獎」後12個月內第三度獲得客戶獎勵肯定。
- ◆ 105年5月19日榮獲歐洲重量級IDM半導體公司於全球供應商日頒發 Best Supplier Award-Subcon Services 獎項。共九家廠商獲得 Best Supplier Award 獎，分別代表重要採購項目、技術和品質等領域的最佳供應商。
- ◆ 105年9月本公司和新加坡子公司同時榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠頒發「Best EWS OSAT Strategic Partnership Award 獎項」。

欣銓集團與主要投資

Ardentec HQ (Taiwan)

- Testing solutions and Technology Development Center
- Hsinchu Industrial Park (K-Site、T-Site、G-Site、P-Site)

100%

Ardentec-Singapore

(Woodlands Factory)

Ardentec-Korea

(Pyeongtaek Factory)

Ardentec JAPAN

(Tokyo Office)

Ardentec Nanjing Co., Ltd.

(Nanjing Factory)

100% (2017/8/30)

Giga Solution Tech

- Wireless & RF Technology Development
- Hsinchu Science-Based Industrial Park

32%

Raytek Semiconductor

- WLCSP Technology Development
- Hsinchu Industrial Park

營運據點

- 創立時間：1999年10月
- 上櫃時間：2005年1月 (代號：3264)
- 股本：新台幣 48億5仟5佰萬 (於 2017/06/30)

Taiwan Location : Hsin-Chu Industrial Park



總樓層面積: 24,000 m²
無塵室面積: 9,200 m²



總樓層面積: 19,500 m²
無塵室面積: 9,500 m²



總樓層面積: 10,500 m²
無塵室面積: 5,200 m²



總樓層面積: 24,500 m²
無塵室面積: 14,000 m²



總樓層面積: 9,800 m²
無塵室面積: 3,400 m²



總樓層面積: 27,500 m²
無塵室面積: 2,200 m²



總樓層面積: 16,500 m²
無塵室面積: 3,800 m²

Nanjing

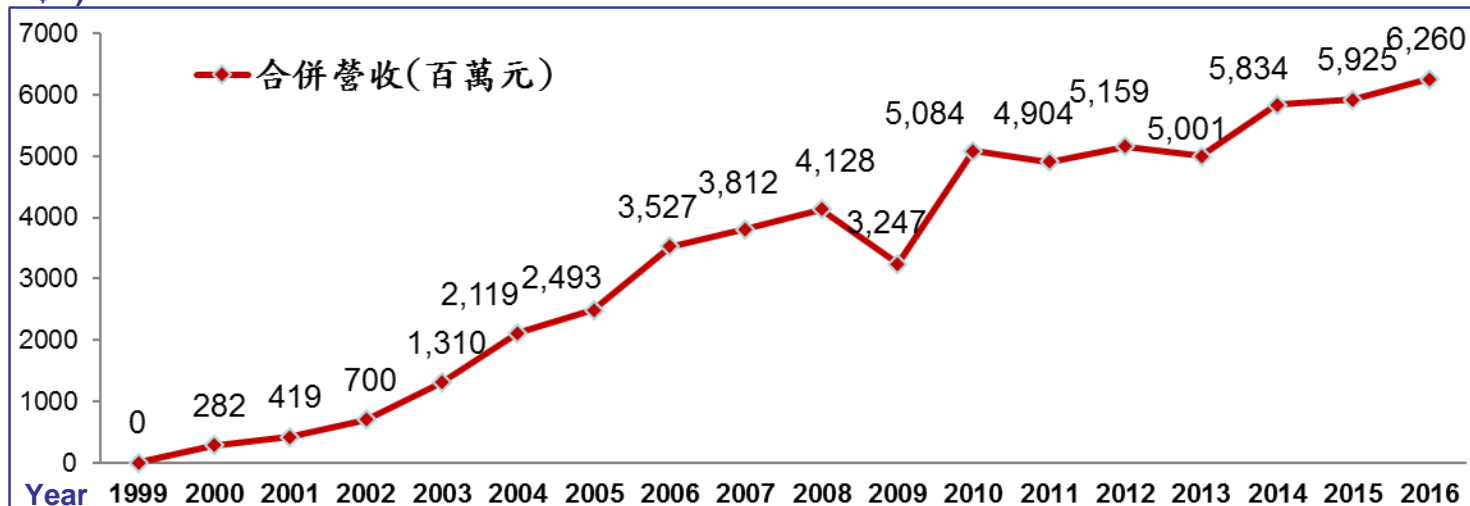
Korea

Taiwan
Hsin-Chu

Singapore

優異的營收成長(合併營收)

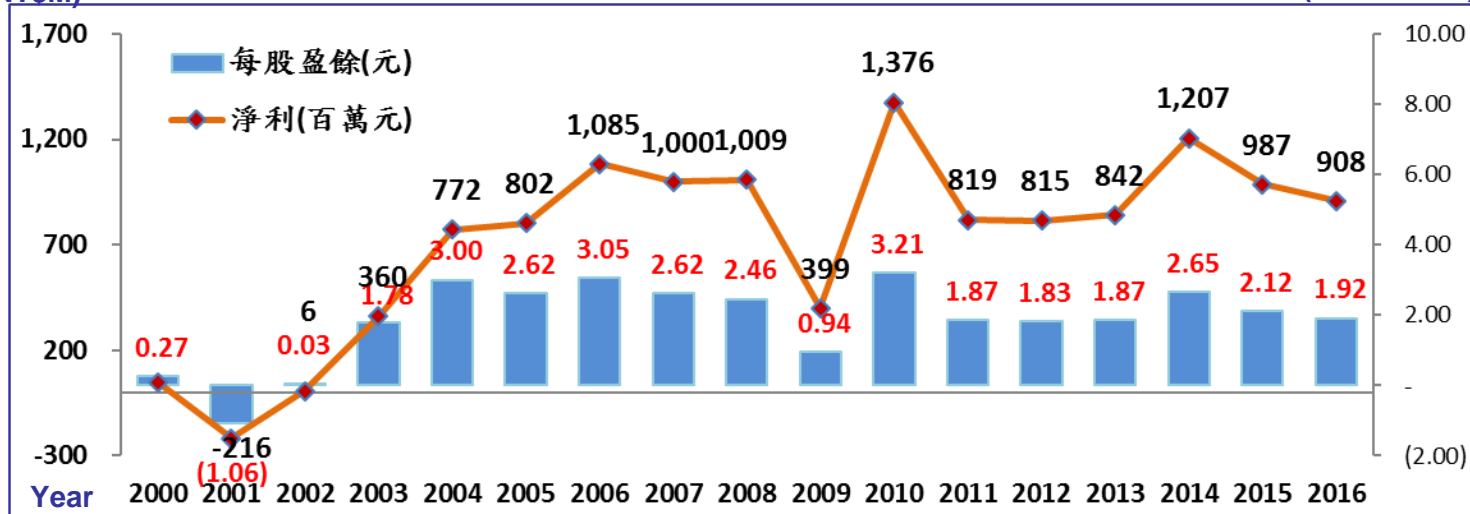
(in NT\$M)



1H/2017
 營收達
NT\$3,670M

YoY 34.8% 

(in NT\$M)

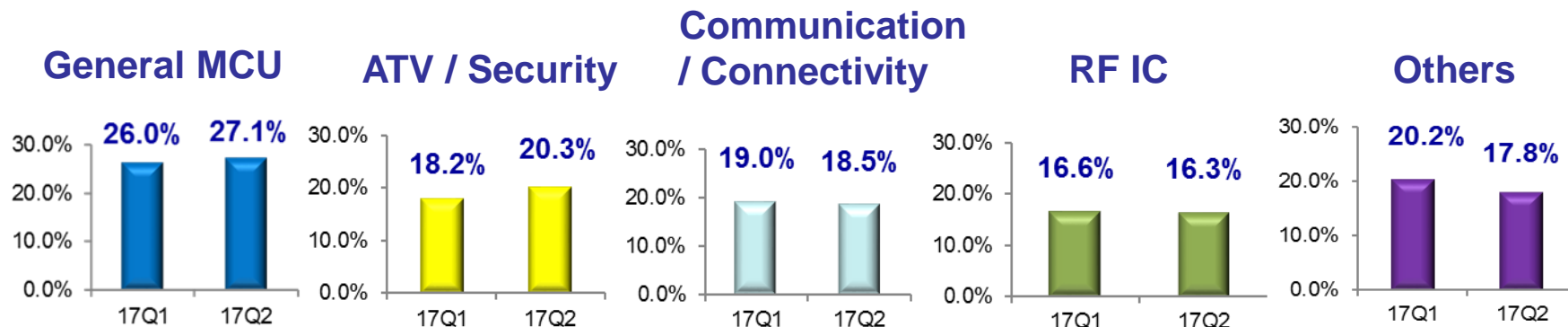
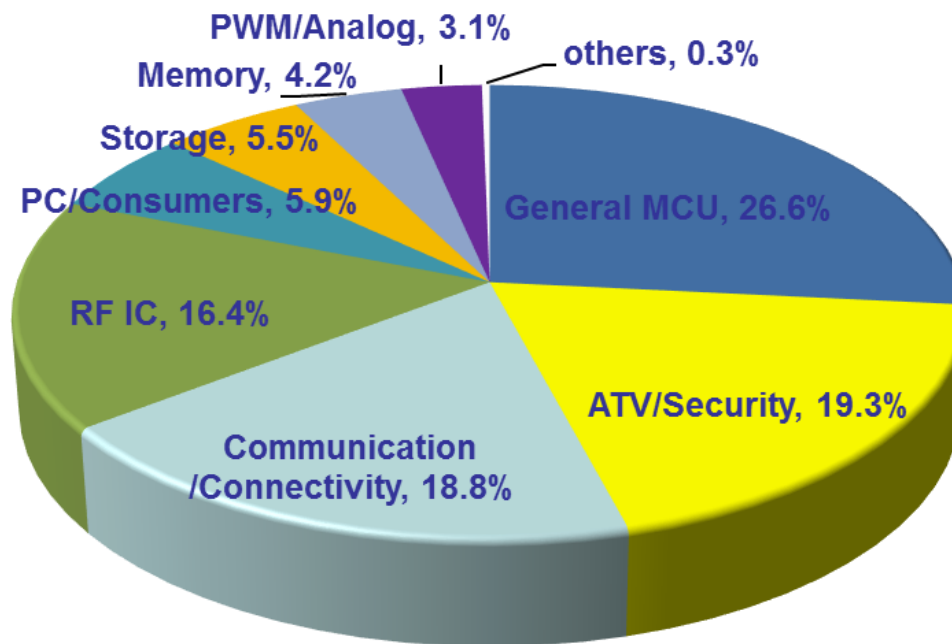


1H/2017
 淨利NT\$467M
EPS NT\$1.03

淨利
 YoY
 40.7% 

EPS
 YoY
 45.1% 

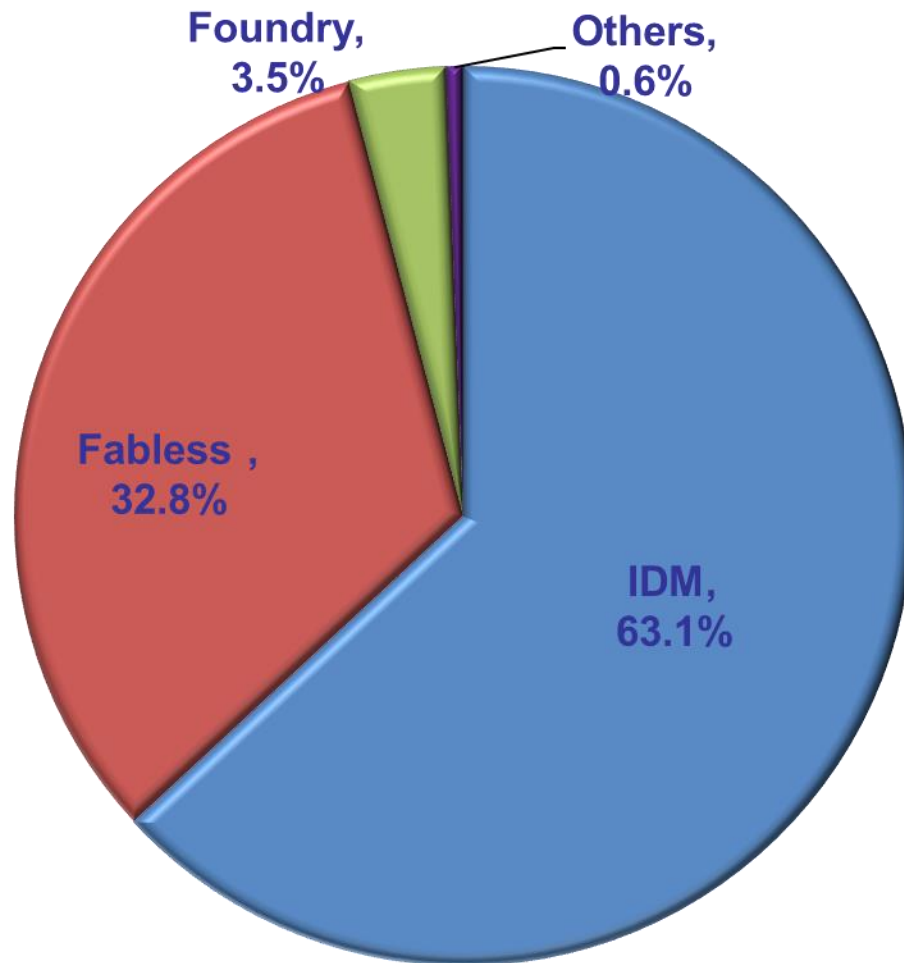
2017上半年測試營收分析-應用別



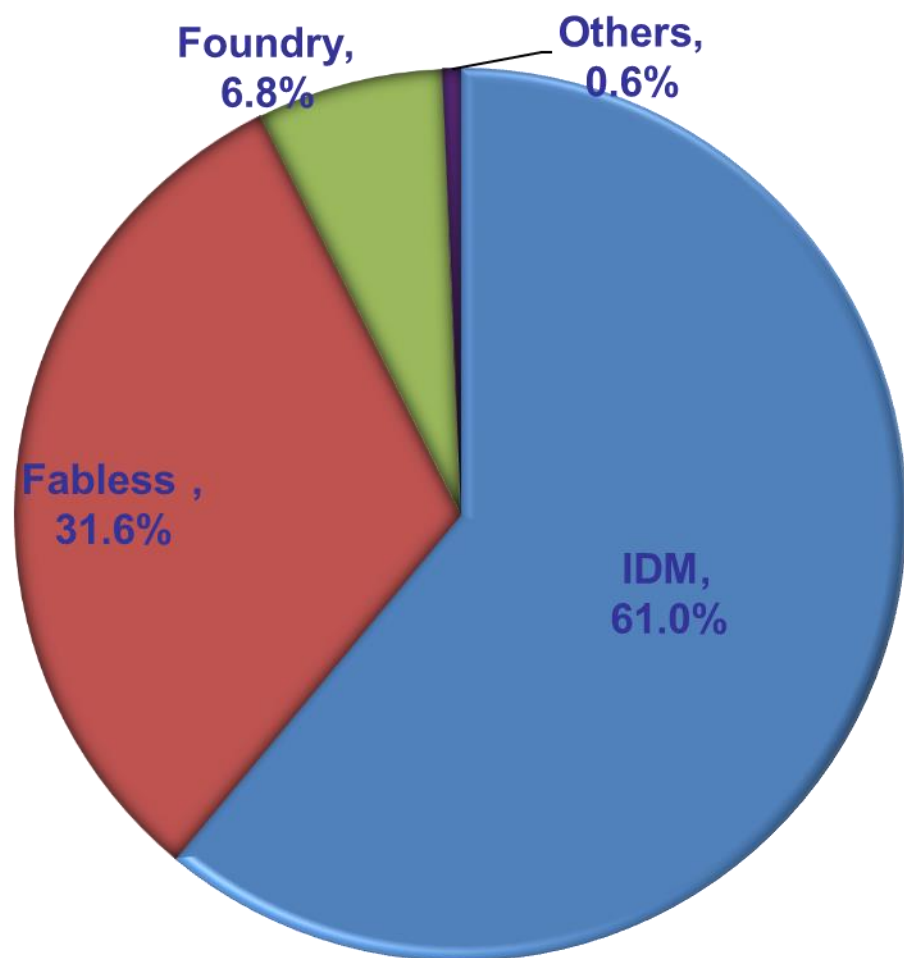
營收分析-客戶別



2017 1H



2016 2H





2017年上半年營運成果

經營績效-2Q17

綜合損益表項目 (NTD M)

	2Q17	1Q17	季變化
營業收入	1,869	1,801	3.8%
營業毛利	531	487	9.0%
毛利率	28.4%	27.0%	+1.4 pts
營業利益	329	314	4.8%
營業利益率	17.6%	17.5%	+0.1 pts
營業外收入及支出	(3)	(46)	93.5%
本期淨利	239	228	4.8%
歸屬於母公司之淨利	252	227	11.0%
歸屬於母公司之淨利率	13.5%	12.6%	+0.9 pts
每股盈餘	0.54	0.49	10.2%

經營績效-1H17

綜合損益表項目 (NTD M)	1H17	1H16	年變化
營業收入	3,670	2,723	34.8%
營業毛利	1,018	666	52.9%
毛利率	27.7%	24.4%	+3.3 pts
營業利益	643	411	56.4%
營業利益率	17.5%	15.1%	+2.4 pts
營業外收入及支出	(49)	0	-167.1%
本期淨利	467	332	40.7%
歸屬於母公司之淨利	479	332	44.3%
歸屬於母公司之淨利率	13.1%	12.2%	+0.9 pts
每股盈餘	1.03	0.71	45.1%

財務狀況及重要財務指標

資產負債表項目 (NTD M)

	End of 1H17		End of 2H16		End of 1H16	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及無活絡市場之債券投資	4,046	25%	3,650	23%	3,294	26%
應收帳款	1,562	10%	1,550	11%	1,092	8%
其他流動資產	263	2%	211	1%	154	1%
長期投資	416	2%	437	3%	96	1%
不動產、廠房及設備	8,857	55%	8,888	57%	8,243	62%
其他非流動資產	890	6%	902	5%	267	2%
資產總計	16,034	100%	15,638	100%	13,146	100%
流動負債	3,601	22%	2,527	16%	2,280	18%
非流動負債	2,051	13%	2,580	17%	1,608	12%
負債總計	5,652	35%	5,107	33%	3,888	30%
歸屬於母公司之權益	9,614	60%	9,751	62%	9,258	70%
股東權益總計	10,382	65%	10,531	67%	9,258	70%
重要財務指標						
流動比率	163.0%		214.2%		199.1%	
固定資產週轉率(年化)	0.83		0.70		0.63	
歸屬於母公司股東權益報酬率(年化)	9.9%		9.3%		7.1%	

現金流量

現金流量表項目 (NTD M)

	1H17	1H16
期初現金及約當現金餘額	2,971	2,349
營業活動之現金流量	1,701	1,235
無活絡市場之債券工具減少(增加)	51	(127)
取得不動產、廠房及設備	(978)	(192)
其他投資活動	47	(15)
短期借款增減數	(210)	(22)
長期借款增減數	(163)	(539)
匯率影響數	(1)	2
期末現金及約當現金餘額	3,418	2,691
無活絡市場之債券投資 (三個月以上定期存款)	628	603
自由現金流量*	723	1,043

* 自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出



問與答



THANK YOU